

## Einbettung aktiver und passiver Komponenten in die Leiterplatte



Von der Europäischen Union werden derzeit zwei Projekte zur Weiterentwicklung von Leiterplattentechnologien gefördert. In beiden Projekten geht es um die Einbettung elektronischer Komponenten in die Leiterplatte. Im Projekt HIDING DIES werden aktive Chips in die Aufbau- lagen starrer Leiterplatten integriert. In SHIFT wird eine weiter gefasste Technologieplattform für die flexible Leiterplatte entwickelt, wo neben verschiedenen Aufbautechnologien, -Prozessen und -Varianten die Einbettung von passiven und aktiven Komponenten in die flexible Leiterplatte der Schwerpunkt der Technologieentwicklung ist. Ziel beider Projekte ist es, eine mittelfristige Umsetzung dieser Technologien in der Produktion zu ermöglichen, wobei die dazu erforderlichen Investitionen für den Leiterplattenher- steller gering sein sollen. // At present, the EU is funding two projects for fur- ther development of printed circuit board techno- logy. Both involve the embedding of electronic components into the board. In the HIDING DIES pro- ject, active chips are integrated into the build-up layers of rigid boards. In the SHIFT project, a more comprehensive technology platform is being developed for flex boards where, in addition to the various build-up processes, the embedding of passive and active components in the flex board is the focus of the new approach. The aim of both projects is to transfer the technology, on a medium time-scale, into production, in order to reduce the investment required for the pcb manufacturer.

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

ermäßigter Preis 2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)